

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma



# Systeme de dépôt de couches minces par pulvérisation

**DP 650**



*by*

**allianceconcept**

## Systeme modulaire et évolutif pour tous types de dépôts et matériaux

**Equipement de pulvérisation cathodique** versatile à souhait, le bâti DP650 possède une chambre circulaire de diamètre 650 mm. Ce volume permet d'accueillir à titre d'exemple soit **quatre sources de 200 mm**, soit **six sources de 100 mm**.

Bénéficiant des développements communs de notre gamme d'équipement de pulvérisation cathodique, ce système est un de nos produits phares.

Réalisé à des dizaines d'exemplaires autour du monde, il est le fer de lance de la gamme sputtering. Tant développé pour des **applications industrielles** que sur des **thématiques R&D**, l'équipement DP650 est l'outil adéquat.

*"Best seller" de la gamme, ce système est un équipement fiable et robuste.*



### Caractéristiques générales

Diamètre enceinte :	650 mm
Hauteur :	320 mm
Volume :	Environ 110 litres
Vide limite (configuration turbo + palettes) :	$5.10^{-7}$ mbar <sup>[1]</sup>
Vide limite (configuration cryogénique) :	$5.10^{-8}$ mbar <sup>[1]</sup>
Capacité machine :	6 x positions 100 mm
Uniformité planar :	< +/- 5% <sup>[1]</sup>
Possibilité sas :	Oui
Implantation passe-paroi :	Oui
Pilotage machine :	- Gestion des procédés - Traçabilité

<sup>[1]</sup> Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

